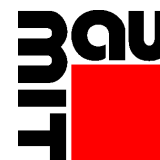


Biała, elastyczna zaprawa klejowa FlexMarmor (Baumit FlexMarmor)



baumit.com

Produkt	Wysokoelastyczna, wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wiążąca, ulepszona, tiksotropowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa na bazie białego cementu o wydłużonym czasie otwartym. Sklasyfikowana wg normy PN-EN 12004:2002 - C2TE S1. Zaprawa o podwyższonej wytrzymałości na odkształcenia poprzeczne.	
Przeznaczenie	Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków w tym w miejscach ekspozowanych na wodę i mróz, oraz podlegających odkształceniom (tarasy, balkony, elewacje itp.) Do układania wszelkiego rodzaju płytek i płyt klinkierowych, z kamienia naturalnego i ceramicznych, w tym płytek gresowych na ścianach i podłogach. Z uwagi na biały kolor nie powoduje przebarwień jasnych płytek z kamienia naturalnego. Odporna na działanie obciążeń termicznych (np. ogrzewanie podłogowe) i statycznych (odkształcenia podłoża). Przeznaczona również do układania płytek na istniejące płytki ceramiczne.	
Skład	Biały cement, piaski, dodatki	
Dane techniczne	(w warunkach normatywnych – w temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%) Zużycie: ok. 3 kg/m ² , zależnie od rodzaju płytek paca zębata: 4 6 8 10 12 mm zużycie około: 1,5 2,5 3,5 3,0 4,5 kg/m ² Zapotrzebowanie wody: ok. 6,5 l/worek 25 kg; Czas leżakowania: ok. 15 minut Czas użycia: do 4 godz. Czas otwarty: do 30 min. Czas korygowania: do 5 min. Grubość warstwy: 2 - 10 mm	
Forma dostawy	Worek - 25 kg 42 worki/paletę = 1050 kg	
Przechowywanie	W suchym miejscu, na paletach - 12 miesięcy.	
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
Podłoże	Musi być twarde, zwarte, stabilne, niemrożone, odpylone i odtłuszczone oraz wolne od oleju. Stosować na: beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, kartonowe płyty gipsowe, gipsowe ścienne płyty budowlane, jastrychy anhydrytowe (odpowiednio zagruntowane); w obrębie pomieszczeń mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, w obrębie tarasów, elewacji i ogrzewania podłogowego, basenów i zbiorników wodnych. Nie stosować na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania; Przygotowanie podłoża: oczyścić z pyłu i kurzu, zagruntować odpowiednim preparatem: - podłoża chłonne: Baumit Grund - podłoża o zmniejszonej nasiąkliwości: Baumit SuperGrund	
Obróbka	Zalecane narzędzia: Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca zębata, kielnia, gąbka paca 3 x 3 mm - klejenie mozaiki paca 6 x 6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim paca 10 x 10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym	

Przygotowanie produktu:

Wsypać zawartość worka do odpowiedniej ilości czystej wody (patrz - dane techniczne) i mieszać przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać ok. 15 minut i ponownie przemieszać zaprawę.

Stosowanie:

Nanosić zaprawę klejową na podłoże w 2 kolejnych etapach. Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanieść i rozprowadzić cienką, kontaktową warstwę kleju, a następnie - na jeszcze wilgotną warstwę pierwotną - nanieść odpowiednią warstwę zaprawy, równomiernie ją rozprowadzając (pacę utrzymywać pod kątem 45-60 stopni do podłoża). Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.

Zalecane pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej):

- wewnątrz budynków > 65%

- na zewnątrz budynków oraz przy ogrzewaniu podłogowym > 90%

Zapewnienie pełnego kontaktu płytki z klejem można otrzymać poprzez układanie płytek metodą kombinowaną (BUTTERING – FLOATING), polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na spód płytki. Przed klejeniem płytek nietypowych bądź nieznanego rodzaju, należy wykonać - na niewielkiej powierzchni - test przyczepności zaprawy klejowej.

Wykończenie:

Przez ok. 24 godziny chronić klejoną powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi (nie chodzić i nie obciążać ułożonych płytek).

BHP

Wszelkie informacje dotyczące specyficznych właściwości produktu, jego składu, sposobu posługiwania się oraz czyszczenia i usuwania odpadów znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Uwagi

Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin.

Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C i powyżej + 30°C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego utwardzenia.

Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania i utwardzania! Nie dodawać żadnych innych materiałów!

Nie moczyc ani podłoża ani płytek.

Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu otwartego - schnięcia naniesionej na podłoże zaprawy klejowej.

Po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.